

低温接合技術とその応用

有機エレ材研(JOEM)

《日時》 2012年10月5日(金) 13時30分～19時00分

《会場》 早稲田大学 研究開発センター

<http://www.waseda.jp/jp/campus/waseda.html>

(所在地: 東京都新宿区早稲田鶴巻町 513 TEL: 03-5286-9067)

《プログラム》

座長 早大 水野 潤

13:30~14:20 「低温接合技術と高機能センサへの応用」

東大 先端科学技術研究センター 日暮 栄治

14:30~15:20 「透明樹脂材料と電子回路基板の低温大気圧混載接合」

物質・材料研究機構 重藤 暁津

15:30~16:20 「実用化に向けた 2.5D/3D

積層デバイスの最先端技術と業界動向」

IBM 折井 靖光

16:20~17:00 補充討論・総括討論

17:00~19:00 懇親会

参加費: 参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費(要旨集代含む)として5,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費: 3,000円を当日受付にて申し受けます。

参加登録: 参加登録, 登録の変更は, 9月28日(金)までに, 次へお願いします。

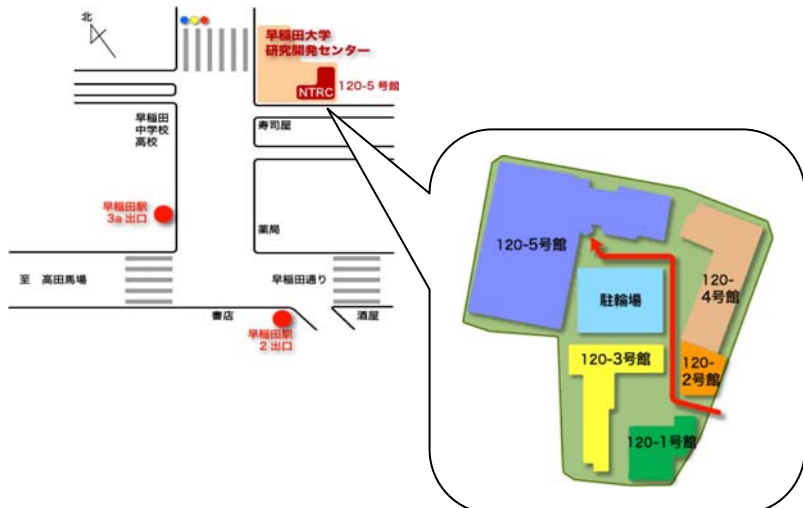
(1) Web site: <http://www.organic-electronics.or.jp> 経由『参加登録』画面

(Yahoo などでも検索できます)

(2) FAX: 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

社団法人有機エレクトロニクス材料研究会(JOEM:The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)



・早稲田駅(東京メトロ東西線)で下車し、2出口
または3a出口から地上に出ます。
*建物に入りましたらすぐに右に曲がり左記地図を
ご参照いただき赤い線の指示通りに進んで下さい。
*会場(120-5号館(ASMew))は建物入口に「先端科学・健康医療融合研究機構」と標記してあります。